

王洪鹏：砥砺前行“芯”可能

► 黄乐媛

“中茵微电子”的创始人王洪鹏身上同时有着学者和企业家的气质：谈起技术来像学者一样严谨，对集成电路领域的前沿信息如数家珍，管理起公司来也运筹帷幄，冷静而卓有远见。几年前，毕业于清华大学电子工程系的他从海外回国工作，很快升到了管理层，然而一股莫名的无力感随之袭来。“最大的问题在于对自己的未来缺乏掌控，只要给别人打工，按照别人布局好的战略和方向做事，你就不可能有自己核心的战略和产出。”于是，事业蒸蒸日上的时候，辞职创业的想法也在王洪鹏心里酝酿成熟，他希望通过创业这条道路，重新实现自我价值。

困难当前， 专注做好眼前的事

2020年底，王洪鹏真正开始了创业，巨大的心理落差击中了他。王洪鹏过去的公司是美资企业，在市场中的地位很高、很受重视。而初创公司没有名气、缺乏资源，无论是招揽人才、吸引客户，还是拓展供应商，都困难重重。

2021年，公司遭遇了产能

危机，而2022年的半导体行业下行大周期，又打了他们一个措手不及。然而王洪鹏和他的创业伙伴很快调整好了心态，“所有的资源和结果都是围绕着你当时的状态而产生的，我们始终觉得人要认清现实，找到当时最优势、最有把握的事情去做，做好了以后再去做不断迭代。”在王洪鹏眼里，创业本质上是一个天时地利人和的过程，创业者既需要在经验、人脉、资源方面有长期、大量的积累，也需要敏锐地发现市场上快速增长的机会，在合适的时间点上做正确的事情。等到所有的一切都积累完成之后，达到了一个质变的临界点，成功也会自然而然的降临。

在接连不断的逆境面前，中茵微电子的团队一次又一次见招拆招，按照当时的情况找到最优解，用“以速度为先、以结果为先”的方法走完了这段路。依托在行业中多年建构起的人脉网络和良好声誉，他们一遍遍向潜在合作者讲述着企业的价值，拿到了银行的贷款，顺利解决了产能问题。在整个行业的市场都处于萎缩状态的时候，中茵微电子凭借着前期的充分准备实现了逆势增长。



王洪鹏 |

1999年考入清华大学电子工程系，中茵微电子创始人。

创业的过程中，王洪鹏曾经三次参加清华校友三创大赛，取得了不俗成绩的同时，每次参赛都令他感触颇深。比赛中取得名次意味着公司的技术和市场定位得到了更多人的认可，逐渐打开了知名度。然而最宝贵的收获还是通过参赛结识到的许多优秀的校友创业者和投资人，王洪鹏和他们成为了朋友，并从他们那里得到了许多建议，不断实现自我迭代，与一群志同道合的人共同成长。

秣马厉兵， 向着技术之巅进军

王洪鹏的本科和硕士学位都

是在清华园中取得，清华精神早已与他的人生密不可分。在清华遇到的所有良师益友中，他的导师王志华教授对他的影响尤为深刻。导师反复强调着两条：第一，无论做什么行业，走到最后一定会来到无人区，遥遥领先于其他人，这个时候是没有任何路径可以学习的。只有长期积累自己的能力和认知，找到那条路径，才能做到最强；其次，在任何领域，做任何事情，都要勇争头部，比如开公司，前200个都可以上市，但是只有努力做大做强，做到前20，才是真正的价值。中茵微电子创立后，王洪鹏谨记恩师教诲，秣马厉兵，带领团队向着无人区不断进军，他为中茵微电子描绘的蓝图，就是在未来成为中国乃至全球的行业领导者。

作为新兴的集成电路技术平台公司，中茵微电子将目光放在技术的迭代和先进性上。在大量的技术及体系积累的支撑下，保证一次性把技术做好，而不需要大量的尝试，这是中茵微电子与其他同类厂商相比最大的优势所在。中茵微电子提供的技术为大量产品平台的生产保驾护航。

以IP为例，中茵微电子的IP包含了分散在所有节点上的高速SerDes，一开始生产的32G SerDes在CPU、GPU、智能网卡等领域有着广泛的应用；而正在研制中的112G SerDes在技术上则



更加先进，同国际主流标准接轨。公司的主要产品还包含了AI和异构芯片，能够满足训练大模型所需要的硬件支撑。另外，公司也开发了一些工业和车用级的IP，适用于不同应用场景的需要。

锚定目标， 实现以中国为中心的国际化

大学期间，另一位恩师魏少军教授经常给学生们讲述国内外形势变化，其中令王洪鹏记忆犹新的有两点，一个是要自己解决技术问题，自力更生；同时，在自力更生的前提下，还要不断国际化，要把影响力和价值散播出去。

在世界范围内，中国的集成电路行业发展远远落后于美国，IP领域的国产化率只有不到百分之五。王洪鹏将这一落后归因于时间，任何领域的上游积累都需要非常漫长的时间，美国从上世纪五十年代开始发展集成电路，在几十年间积累了大量的经验和历史认知。而中国刚刚开始做IP，要实现产品达到和国际同行

同样的、甚至是领先于他们的能力和标准，就必须要在每个领域都突出重围。

行业内存在着一个共识：AI时代集成电路发展的整体动力来源于计算，以及计算所产生的数据的价值和计算平台的不断迁移。由此，以算力芯片为核心，包括传感、存储、运输等一系列芯片在内的企业级芯片的需求正在激增；同时，像智能汽车、AR眼镜等可移动的智能设备也是值得期待的领域。由此，王洪鹏认为，目前集成电路领域的核心动力和发展方向是AI+计算，这一方向也要求集成电路技术更上一层楼。随着芯片工艺日益精细，最新工艺走到了2nm，物理尺寸接近极限，摩尔定律遇到发展瓶颈，但市场对芯片性能的要求却没有降低。因此必然要另辟蹊径来满足日新月异的发展需要，而在王洪鹏看来，Chiplet和异质集成就是理想的解决方案之一。当2D芯片无法满足应用需求时，就需要继续研发2.5D、3D的芯片，通过堆叠和互联，把集成的层次拉到封



王洪鹏参加清华校友三创大赛

装级，这是中茵微电子正在努力的重要方向。

通过高速接口 IP、高速储存 IP 以及 Chiplet 互联 IP 去构建技术底层和护城河，再把这些 IP 应用于设计服务领域，帮助客户成功设计出大型企业级芯片，同时也制作一些互联交换类型的 Chiplet 供大家使用，中茵微电子以自己选定的方式来为整个行业的高速增长奠定根基。

“中国是全世界除了美国以外唯一具备了集成电路全产业链、全工业能力的国家，只要我们愿意去做，一定可以把成本和品控都做到最优秀。工业化体系和人才我们都有了，我们只缺少时间上的投入。”对于中国集成电路的产业发展，王洪鹏很有自信。他期望再过五到十年，我们完全可以实现自给自足，不断缩小差距，甚至实现反超。

在实现了自给自足之后，王

洪鹏的下一个目标是国际化。“不是以美国为中心的国际化，而是以中国为中心的国际化。”王洪鹏期待着有朝一日我们可以将自己的技术和产品出口给有需要的国家，给国家带来更大的产值和利润，靠出口高科技产品而不是简单的工业制成品来跨过中等收入陷阱，延续价值链。

不急一时， 怀着清晰的认知始终前行

蒋南翔校长提出“为祖国健康工作五十年”，这深深镌刻在每一位清华学子的脑海中。从王洪鹏毕业到现在二十年转瞬即逝，“健康工作五十年”的目标还在前方。对王洪鹏来说，人生最大的价值是长久贡献和产出，而不在一城一地的得失，无论是生活还是创业，都要重视前期积累势能，才能在未来收获成果。

王洪鹏将创业者身上必备的素质总结成了四点，首先要有战略能力，要有清晰的认知，了解自己对手在行业中的地位，有能力制定战略，找到最适合的发展路径。创业的时机取决于行业的性质，像集成电路这样的行业，需要在业界长期沉淀才能具备独立创业的能力，因此不能急于一时。在有了战略能力之后，还要找到自己的核心市场和定位，回答好“别人为什么需要你、你为什么可以活下去”这两个问题。自己有了成熟的想法后再开始集结团队，塑造团队凝聚力。创业不是一个人的事情，而是需要不同的角色，这中间有人专攻技术、有人部署战略、有人开拓市场，创业者需要强大的说服能力和个人魅力，在一无所有的时候拉到一群愿意同自己携手并肩的伙伴。同时，创业者必备足够坚韧的自信心，尽管艰难险阻，心中必须始终坚信这件事情是一定可以做成的。

随着团队的发展壮大，“以终为始”这四个字伴随着王洪鹏，并将激励他继续前行。多数公司的生命周期有限，因此创业者一定要清楚自己真正的目标是什么，明白到什么阶段就无法再实现增长了。在适当的时候结束，总结过去的价值，寻找未来的新机会，未尝不是一个理想的结局。🍊

中茵微电子企业简介

中茵微电子（南京）有限公司是一家专注于做先进制程工艺 IC 设计，致力于 IP 自主研发和服务、赋能芯片设计和 SoC 定制解决方案的技术平台公司，主要面向高性能计算、数据中心、5G 通信、人工智能、汽车电子等领域。

中茵微电子拥有顶尖的全球资深技术专家团队并积累了优秀的产业资源，致力于利用全球领先的集成电路设计平台，为客户提供先进制程 IP、一站式的高端 SoC 定制以及 Chiplet& 先进封装产品。目前中茵微电子已经成为企业级的先进工艺接口 IP、ASIC 服务、Chiplet 与先进封装设计等领域的一流

供应商，并与国内外知名产业链伙伴达成深度合作。

中茵微电子核心团队组建于 2017 年 7 月，于 2021 年初作为重大项目落地南京浦口，得到当地政府大力支持，并在无锡设立子公司。中茵微电子有来自于华为、AMD、GUC、Intel、Alchip、Synopsys、Cadence、Marvell 和 Faraday 等顶级设计公司的国内技术团队，以及北美的技术专家。团队成员在先进制程的芯片量产研发及 IP 设计等方面经验丰富。自成立至今，中茵微电子已实现累计近十亿元订单，深入绑定众多行业头部客户，获得众多投资机构青睐并完成数亿元 A 轮融资。



企业诉求

1. 人才招聘需求：欢迎 IP 模拟设计、IP 和 SoC 数字设计、IP 和 SoC 数字验证、DFT、数字后端、测试等技术专业人才，base 南京、无锡、上海、苏州、合肥、成都均可。简历投递：hr@joinsilicon.com
2. 融资需求对接
3. 客户资源或项目资源对接，主要为高速 32G & 112G SerDes、LPDDR5、D2D、ONFI5.1 等高速接口 IP，Chiplet2.5D、3D 先进封装，一站式 ASIC 设计和 SoC 定制设计等。